

SIP设计仿真生产技术服务

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SIP设计仿真生产技术服务 |
| 公司名称 | 上海唯紫信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区汇贤路758号4幢3113室 |
| 联系电话 | 13611662322 13611662322 |

产品详情

随着世界的高速发展，人们对于电子产品的需求越来越强烈，越来越多样化。以消费品为例来看的话，电子产品集成度在变高，芯片尺寸在变小，单位面积的芯片实现的功能在变多，实现的效率在变快。当这样的需求传导到整个半导体行业时，每个细分的子行业和公司会提出不同的解读和方案。目前，这样的需求被分解得到的结果是：数字IC设计越来越复杂，晶圆工厂制造的Chip尺寸越来越小，封装厂把更多的芯片一起塑封，PCB的尺寸及贴片组装能力也在趋近极限。

当前SiP的发展中有一个主要的对比产品是原来的PCB板件产品，即将以前在PCB板件上实现的功能现在缩小到SiP级别实现，从而达到小型化高集成度的目标。作为对比，SiP有以下几个优势：

- I SiP模块的面积、体积有效减小，使PCB板面积大大减小；
- I 从板级电路变成一颗SiP模块，面积减小，抗振动能力显著提升；
- I 内部互联线变短，芯片和芯片之间取消封装引脚，取而代之的是键合线及基板上的导线，寄生电容、电阻、电感数量级减小，因此功耗、传输延时也会随之降低，显著地提升了电路的电性能；
- I 传输路径变短，对外产生的干扰也相对减小，可降低噪声和EMI问题；

上海唯紫作为一家集成电路与电子系统研发综合服务提供商，我们提供SiP及3D-IC/2.5D-IC先进封装的设计与生产一站式服务。专业的Sip与先进封装设计团队，设计过各种功能的SiP产品，从消费级到工业级涵盖了各行各业，能为客户提供快速高效低成本的设计方案。技术团队拥有全流程EDA工具及使用经验，可以提供完整的芯片/封装/系统Co-Design和多物理场封装系统分析，我们的仿真工程中心具备SiP/先进封装需要的SI/PI/EMC/热/结构分析能力，提供从封装到系统级仿真的整体解决方案。

在多年的封装项目实施过程中，唯紫封装工程团队积累了良好的裸芯片资源供应链，可以帮助客户解决部分裸芯及物料采购问题。在与客户的合作中，我们长年积极拓展封装加工与测试资源，特别是针对复杂的SiP、先进封装，拥有了丰富且稳定的封装厂资源，包括多家具备晶圆级/SiP生产能力的封装厂，还包括多家功率、汽车、IGBT、射频封装厂资源，可以很好地满足客户打样快封或量产需求。我们拥有优质高效的封装制造与测试项目管理体系，具备针对快封和量产的专业管理能力，提供多维度封测服务，保证客户项目顺利高质量地完成封测。